

Title (en)

Process and apparatus for electrolytic welding.

Title (de)

Galvanotechnisches Fügeverfahren und Vorrichtung.

Title (fr)

Procédé et appareillage pour la soudure electrolytique.

Publication

EP 0432559 A1 19910619 (DE)

Application

EP 90122577 A 19901127

Priority

DE 3941128 A 19891213

Abstract (en)

An electrolytic process for producing a metallic joint between two metal surfaces and an apparatus for carrying it out are disclosed. In the process the electrolyte liquid is fed through a rotating electroplating device (1) with built-in anode (4) to the region of the joint and applied to the surfaces (A, B) to be joined. As a result, the immersion of the components in a plating bath is unnecessary. A joint between two components at an acute angle to one another is possible. The plating device is a roller (1) whose shape is matched to the seam geometry. Preferably, the roller (1) is made of an elastic material. <IMAGE>

Abstract (de)

Es wird ein galvanotechnisches Verfahren zur Herstellung einer metallischen Verbindung zwischen zwei Metalloberflächen und Vorrichtung zu seiner Durchführung vorgestellt, bei dem die Elektrolytflüssigkeit durch eine rotierende, galvanische Beschichtungsvorrichtung (1) mit integrierter Anode (4) in den Verbindungsbereich und auf die zu verbindenden Oberflächen (A, B) aufgebracht wird. Dadurch entfällt das Eintauchen der Bauteile in ein galvanisches Bad. Eine Verbindung zwischen zwei unter einem spitzen Winkel zueinander stehenden Bauteilen ist möglich. Die Beschichtungsvorrichtung ist eine in ihrer Form der Nahtgeometrie angepaßte Rolle (1). Vorzugsweise ist die Rolle (1) aus einem elastischen Material hergestellt. <IMAGE>

IPC 1-7

C25D 5/00; C25D 5/06

IPC 8 full level

B23K 28/00 (2006.01); **C25D 5/02** (2006.01); **C25D 5/06** (2006.01); **C25D 5/22** (2006.01); **C25D 17/14** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C25D 5/06 (2013.01 - EP US); **C25D 5/22** (2013.01 - EP US); **C25D 17/14** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] US 4655881 A 19870407 - TEZUKA JUNICHI [JP], et al
- [A] US 2603593 A 19520715

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

DE 3941128 C1 19901206; EP 0432559 A1 19910619; JP 2549763 B2 19961030; JP H03221291 A 19910930; US 5248404 A 19930928

DOCDB simple family (application)

DE 3941128 A 19891213; EP 90122577 A 19901127; JP 32055190 A 19901122; US 62520690 A 19901210